

Bryssel den 21 november 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

FÖLJENOT

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
inkom den:	19 november 2018
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	C(2018) 7499 final – Annex
Ärende:	BILAGA till kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar

För delegationerna bifogas dokument – C(2018) 7499 final – Annex.

Bilaga: C(2018) 7499 final – Annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

BILAGA

till

kommissionens delegerade direktiv

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar

BILAGA

I bilaga III ska punkt 15 ersättas med följande:

”15	Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar	Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11 och löper ut – den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument, – den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.
15 a	Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar, där minst ett av följande kriterier är uppfyllt: – En halvledartekniknod på minst 90 nm. – En enda skiva på minst 300 mm² någon av halvledartekniknoderna. – Staplade skivpaket (stacked die packages) på minst 300 mm², eller kiselmellanlägg på minst 300 mm².	Tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 21 juli 2021.”